



テクダイヤ株式会社

会社説明

5G・データセンター・宇宙開発から、スマートフォン・3Dプリンティングまで、未来に向けて必要な製品を供給するメーカーです。“Work Hard Play Hard”をモットーに、仕事だけでなくプライベートの充実も追求する会社です。

半導体組立技術（CM事業）

フィリピン・セブ島で、通信技術の要である半導体部品の製造を行っています。フィリピンは世界の中でもトップクラスの海外生産先として知られ、手先の器用さ、英語でのコミュニケーションなど、地の利を生かしたものづくりを行っています。

セラミック応用技術

セラミックを用いた電子部品がテクダイヤの主力製品です。用途は5G通信、衛星または世界のデータセンターほか半導体通信市場。グローバルニッチ市場でシェアナンバー1を獲得しています。

精密機械加工技術

機械加工とは、金属などを専用機械で様々な形状に加工することです。この技術を使ったミクロン単位での精巧なものづくりが、スマートフォン、液晶タブレット、3Dプリンティングなどに寄与しています。

ダイヤモンド応用技術

ダイヤモンドの卸売りから始まったテクダイヤは、ダイヤモンド加工技術を確立し、ダイヤモンド製工具の製造・販売を行う世界有数の企業です。LEDやBlu-Rayなど、様々な業界に製品提供を行っています。

会社概要

本社所在地

日本

事業内容

半導体系電子部品の製造・開発

代表取締役

小山真吾

設立年

1976年6月

資本金

60,000,000円

従業員数

51 - 100人

URL

<https://www.tecdia.com/jp/>

オフィス情報

メインオフィス

〒1080023
東京都 港区 芝浦4-9-25
芝浦スクエアビル17階